

◇◇◇ NPO法人サーキットネットワーク(C-NET)定期講演会 ◇◇◇

◇◇◇
◇◇◇◇ 第24回 ◇◇◇ ◇◇◇◇

◇◇電子立国ニッポンの復活に向けて(PartIV)◇◇

～救世主となる半導体の動向～

主催：NPO法人サーキットネットワーク(C-NET)

協賛：(一社)日本電子回路工業会(JPCA)

協賛：(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)

皆様、今年は夏から一気に寒くなりましたが如何お過ごしでしょうか。

NPO法人サーキットネットワーク(C-NET：理事長梶田栄)では(一社)日本電子回路工業会(JPCA)、(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)の協賛を得て(予定)第24回定期講演会を今回もWebにて開催します。

今回は「電子立国ニッポンの復活に向けて(PartIV)」

～救世主となる半導体の動向～

と題して、半導体関連の各種技術を集めます。奮って参加願います。

* 開催日時：令和6年2月22日(木) 13:00～17:10

* 形態 開催方式：WEB開催 (ZOOM使用)

- ・聴講については、原則開催日の前日までに参加URLとパスワードをご連絡します。
- ・講演の録画、録音、撮影は禁止します。
- ・同業他社の方の参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。

* テーマ：電子立国ニッポンの復活に向けて (PartIV)

～救世主となる半導体の動向～

* プログラム：

◆基調講演◆

13:00～14:00 「チップレット時代の世界半導体市場の今後の展開は？」

津田 建二氏(国際ジャーナリスト)

◆技術講演◆

14:00～14:45 「3Dパッケージング・チップレット集積化技術の最新動向」

福島 蒼史氏(東北大学)

14:45～15:30 「半導体 生かすも殺すも基板次第」

西田 秀行氏(ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

(休憩)

15:40～16:25 「次世代半導体パッケージ用絶縁材料の開発状況」

渡邊 真俊氏(味の素)

16:25～17:10 「仮」先端パッケージ・サブストレートを支える有機基材の最新動向」

尾瀬昌久氏((株)レゾナック)

* 定員 150名(先着申込順定員になり次第締切ります)

* 講演会参加費(テキスト代、消費税込み)

C-NET会員：5000円 JPCA会員：5000円 JIEP会員：5000円 非会員：10000円

C-NET特別会員：無料

* 参加費は2月19日までに請求書記載の銀行口座へお振込ください。

* 申込先 C-NET定期講演会

* 次のURLよりお申し込みください。

URL <https://jisso.jp/reg/cnet24/>

申込されますと返信メールで請求書へのリンクが発行されます。

請求書に従って、銀行振り込みにて参加費のお支払いをお願い致します。

* メールアドレス入力ミスで、返信(受付完了)メールが不達になることが頻発しています。
メールアドレスを入力後の再確認をお願い致します。